## ラマン分光法及びイメージング法による低温多結晶シリコン薄膜の結晶性分布評価

Crystallinity Evaluation Profile of Low Temperature Polycrystalline Silicon Thin Film Using Raman Spectroscopy and Imaging

<sup>o</sup>横川 凌<sup>1</sup>、高橋 和也<sup>2</sup>、小森 克彦<sup>2</sup>、廣田 良浩<sup>3</sup>、澤本 直美<sup>1</sup>、小椋 厚志<sup>1</sup>
(1.明治大理工、2.東京エレクトロン東北㈱、3.東京エレクトロン㈱)

<sup>°</sup>Ryo Yokogawa<sup>1</sup>, Kazuya Takahashi<sup>2</sup>, Katsuhiko Komori<sup>2</sup>, Yoshihiro Hirota<sup>3</sup>, Naomi Sawamoto<sup>1</sup>,

and Atsushi Ogura<sup>1</sup>

## (1. Meiji Univ. 2. Development Dept., Tokyo Electron Tohoku Ltd. 3. Tokyo Electron Ltd.) E-mail: ce51066@meiji.ac.jp

【背景と目的】低温多結晶シリコン(LTPS)は水 素化アモルファスシリコン(a-Si:H)や酸化物半 導体と比べ高移動度のため、薄膜トランジスタ (TFT)のチャネル材料として注目されている。 しかしLTPSの作製条件によってデバイス性能 は大きく異なり空間分解能が高いかつ非破壊 である評価手法の確立が急務となっている[1]。 本研究では UV/可視光励起光源を用いたラマ ン分光法によりLTPS 薄膜作製プロセス及び結 晶性を評価した。

【実験】試料は Si 基板上に 100 nm の SiO<sub>2</sub>膜 を形成後、アモルファスシリコン(a-Si)を LPCVD 法により堆積した。表 1 に a-Si の堆積 条件を示す。その後温度を 625℃ でアニールを 行い時間は 20、40、60、90、180 分とし LTPS を作製した。ラマン分光測定により試料の応力、 結晶性の評価を行い励起光源に紫外光(*λ*=355 nm)および可視光(*λ*=532 nm)を用い分光器の焦 点距離は 2000 nm、さらにはガルバノミラーを 高速駆動させることにより疑似線状化したレ ーザを得た[2]。

【結果・考察】図1にUV励起光源を用いて測 定したラマンイメージング像を示す。横軸は波 数(cm<sup>-1</sup>)、縦軸は位置(μm)を示し疑似線状光源 の長さ 100 µm に対応している。このイメージ から 0.2 µm 間隔で 512 点のラマンスペクトル を同時に取得できる。結晶シリコン(c-Si)は 520 cm<sup>-1</sup>にラマンピークが現れる。図 1(a)-(c)より a-Si 堆積温度が高い試料ほど 520 cm<sup>-1</sup>のピーク が短時間のアニールで現れている事がわかる。 また図 1(d)より 1.5 Torr で堆積させた試料では 0.4 Torr の試料と比べ結晶化が遅いことがわか る。図2に180分アニールを行った試料に関し て図1より抽出したラマンピークの半値幅の 中央値及び分散(2σ)を示す。ラマンピークの半 値幅は結晶性を示しており、c-Siの半値幅は約 3.0 cm<sup>-1</sup>である[3]。ゆえに図 2 から a-Si 堆積温 度が高い、もしくは堆積圧力が低いほどラマン ピークの半値幅は狭くなっているためLTPSの 結晶性は向上し、グレインサイズの拡大もしく は欠陥密度の低下が反映している。以上より、 非破壊で簡便なラマンイメージングを用いる ことでLTPS 薄膜の結晶化プロセス及び結晶性 を評価することができ、将来デバイス作製時の インライン評価等に応用可能であることを示 した。

[1]W. S. Yoo. et al., ECS Trans. 61 (3), 55 (2014).

[2]A. Ogura. et al., Jpn. J. Appl. Phys. 45, 3007 (2006).

[3]K. Kitahara. et al., Jpn. J. Appl. Phys. 38, L1312 (1999).

Table I, Amorphous Si (a-Si) deposition conditions.



**Fig. 1** Raman images obtained by CCD with UV excitation after annealing for the a-Si deposited at (a) 510°C, 0.4 Torr, (b) 530°C, 0.4 Torr, (c) 550°C, 0.4 Torr, and (d) 510°C, 1.5 Torr.



**Fig. 2** The median and variation  $(2\sigma)$  of the full-width-at-half-maximum (FWHM) after 180 min annealing.